

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, R. D., Nuryanti, S. Z., Afriany, R., & Rais, A. (2017). Analisa Pengaruh Jarak Katoda Dan Anoda Dalam Proses Elektroplating Aluminium Terhadap Ketebalan Lapisan. *TEKNIKA: Jurnal Teknik*, 3(2), 142. <https://doi.org/10.35449/teknika.v3i2.47>
- Andinata, F., Destyorini, F., Sugiarti, E., Munasir, M., & Zaini T., K. A. (2012). Pengaruh pH Larutan Elektrolit Terhadap Tebal Lapisan Elektroplating Nikel Pada Baja ST 37. *Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA)*, 2(2), 48. <https://doi.org/10.26740/jpfa.v2n2.p48-52>
- Augustin, A., Rajendra Udupa, K., & Udaya Bhat, K. (2016). *Effect of coating current density on the wettability of electrodeposited copper thin film on aluminum substrate. Perspectives in Science*, 8, 472–474. <https://doi.org/10.1016/j.pisc.2016.06.003>
- Bayuseno, A., & Nugroho, S. (2012). Pengaruh Konsentrasi Larutan dan Kuat Arus Terhadap Ketebalan Pada Proses Pelapisan Nikel Untuk Baja Karbon Rendah. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/rotasi-23->
- Budhi Susetyo, F., Situmorang, E. M. H., Luthfiya, S., & Soegijono, B. (2018). *Copper Electrodeposition onto Aluminum from a Copper Acid Baths in the Presence of Poly Ethylene Glycol (PEG). MATEC Web of Conferences*, 218, 0–4. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201821804026>
- Budiyanto, E., Cahyo Wahyudi, T., & Wayan Suarca, I. (2021). Pengaruh Temperatur Elektrolit Terhadap Ketebalan dan Kuat Lekat Baja Karbon Rendah Pada Proses Elektroplating.
- Gati, N. (2015). 9138-23434-1-PB. 2015.
- Guang, Y., Ying, D., Sheng, Y., Yiyong, F., Jun, W., Shuqiang, G., & Rong, J. (2019). *Early Doppler ultrasound in the superior mesenteric artery and the prediction of necrotizing enterocolitis in preterm neonates. Journal of Ultrasound in Medicine*, 38(12), 3283–3289.
- Machfuroh, T., Pradani, Y. F., & Ghufro, W. (2021). Pengaruh Jarak Dan Waktu Electroplating Terhadap Laju Deposit dan Korosi Aluminium Alloy. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha*, 9(1), 71–79. <https://doi.org/10.23887/jptm.v9i1.32217>
- Manurung, C. (2014). Pengaruh Kuat Arus Terhadap Ketebalan Lapisan dan Laju Korosi (Mpy) Hasil Elektroplating Baja Karbon Rendah Dengan Pelapis Nikel. 21(2), 1857–1869.

- Muthukrishnan, A. M. (2015). *Green Synthesis of Copper-Chitosan Nanoparticles and Study of its Antibacterial Activity*. *Journal of Nanomedicine & Nanotechnology*, 06(01), 1–6.
<https://doi.org/10.4172/2157-7439.1000251>
- Nafis, M. F., Widodo, T., Riyadi, B., Sugito, B., & Partono, P. (2022). Keilmuan dan Keislaman e-ISSN xxxx-xxxx Pelapisan Cu/Ni pada Bahan Aluminium dengan Metode Elektroplating Histori Artikel. 33–41.
- Nurhilal, M., Harjanto, T. R., Bahri, S., & Purwiyanto, P. (2021). Rancangan Alat Elektroplating dan Eksperimen Pelapisan Berbahan CuSO₄ Terhadap Ketebalan Lapisan. *Infotekmesin*, 12(1), 36–41.
<https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v12i1.489>
- Rahmat. (2010). Pengaruh Arus Dan Waktu Pada Pelapisan Nikel Dengan Elektroplating Untuk Bentuk Plat. *METANA*; Vol 6, No 02 (2010): Desember 2010DO - 10.14710/metana.v6i2.3967.
- Selly, R., Rahmah, S., Nasution, H. I., Syahputra, R. A., & Zubir, M. (2020). *Electroplating Method on Copper (Cu) Substrate with Silver (Ag) Coating Applied*.
- Soegijono, B., Susetyo, F. B., Yusmaniar, & Fajrah, M. C. (2020). *Electrodeposition of paramagnetic copper film under magnetic field on paramagnetic aluminum alloy substrates*. *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology*, 18, 281–288.
<https://doi.org/10.1380/EJSSNT.2020.281>
- Suarsana. (2008). Pengaruh Waktu Pelapisan Nikel Pada Tembaga Dalam Pelapisan Khrom Dekoratif Terhadap Tingkat Kecerahan dan Ketebalan Lapisan I Ketut Suarsana. Dalam *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CAKRAM* (Vol. 2, Nomor 1).
- Sumual, H. M. (2012). Pada Aluminium Dengan Metode Elektroplating. *Snttm Xi*, 16–17.
- Suta Waisnawa, G. N. (2014). Alat Simulasi Pelapisan Logam Dengan Metode Elektroplating I Made Sudana¹, Ida Ayu Anom Arsani² dan I (Vol. 14, Nomor 3).
- Wang, S. H., Guo, X. W., Sun, C., Gong, J., Peng, L. M., & Ding, W. J. (2014). *Electrodeposition of Cu coating with high corrosion resistance on Mg-3.0Nd-0.2Zn-0.4Zr magnesium alloy*. *Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)*, 24(12), 3810–3817.
[https://doi.org/10.1016/S1003-6326\(14\)63537-8](https://doi.org/10.1016/S1003-6326(14)63537-8)
- Wang, Y., Lu, X., Yuan, N., & Ding, J. (2020). *A novel nickel-copper alternating-deposition coating with excellent tribological and*

antibacterial property. Journal of Alloys and Compounds, 849, 156222.
<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156222>

